SPRUC 第5回 BLsアップグレード検討ワークショップ SPRUC 5th BLs Upgrade Review Workshop

2023.3.10 Fri 9:00-17:00

10:15 10:30 BL20B2 医学・イメージングI施設担当 登野健介(5分) BL20B2 Medical/imaging BL I Kensuke Tono, JASRI (5 min)

第5回BLsアップグレード検討ワークショップ



BL20B2高度化の概要

-高エネルギー用多層膜ミラー分光器の導入-

JASRI 散乱・イメージング推進室 登野健介

0

多層膜ミラー分光器(DMM)の導入@BL20B2



- 高エネルギーX線(40 keV, 110 keV)の高フラックス化。
- 計算では200-300倍(@40 keV)。
- 2021A期より利用を開始。
- Si-DCMの入替えも実施し、2022A期より新しいDCMで運用している。
- ・ 2022年度にラミノグラフィー測定システムを導入。
- 位相コントラスト測定システム(@40 keV)の整備も計画している。

Koyama et al., JSR 29, 1265 (2022). 光学ハッチ EH1 ~2020/12 2021/04~ M2a/b DCM 30mm X-ray M₁a M1b... 3.5m 2 5_m

多層膜ミラー分光器(DMM)の利用状況(2021A~) JASRI

フラックス[phs/s] (EH1での実測値)

	40keV	110keV
Si-DCM	2.0x10 ⁹	1.8x10 ⁷
DMM (スペクトル幅)	1.3x10 ¹² (4.2%)	3.9x10 ¹⁰ (0.9%)

- ・ 実測値で3桁程度の向上があった。
- 旧Si-DCMの光東密度が計算値より低くなっていたため(結晶ひずみなどの影響)と思われる。新Si-DCMへの更新を実施。

40keVでの高速撮影(20 kHz)



試料:

ヒューズ(250V, 10A)

条件:

40keV, 20kHz 3.0um/pixel 1024x1024 pixels

検出器:

Photron SA-Z GAGG 200um

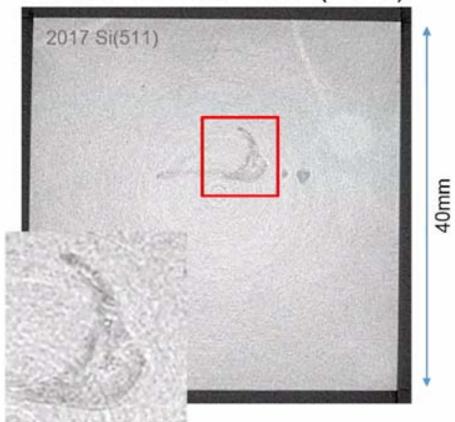
導入後のDMM利用状況 (課題数)

	2021A	2021B	2022A	2022B
40keV DMM	2	12	12	14
110keV DMM	1	2	1	5
Si-DCM	10	13	8	10
計	13	27	21	29

110keVにてCT撮影(@ハッチ3)

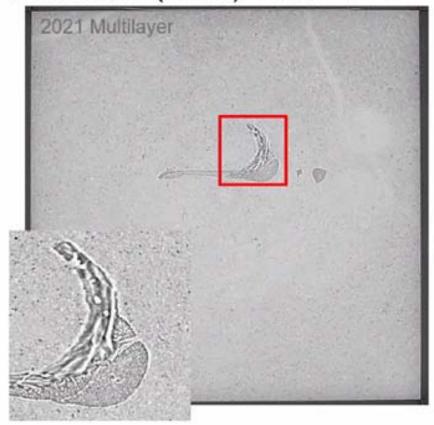


110keV CT with DCM (2017)



110keV, 48.2um/pixel, 1.0sec/projection, 0.1deg/step, 360deg

With DMM (2021) 石灰岩 (化石)



110keV, 17.3um/pixel, 0.15sec/projection, 0.06deg/step, 360deg

左は2017年の撮影。Si DCM (511)を使用。CT撮影条件から求めた光量比はおよそ1000倍となり、実測値と整合している。

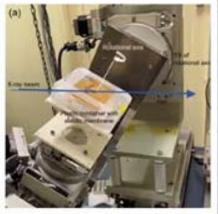
ご協力:北海道大学 竹田博士 4

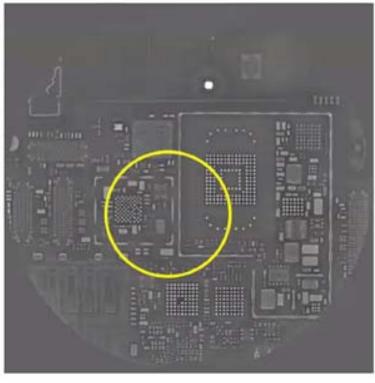
ラミノグラフィー撮影



Hoshino et al., J. Synchrotron Rad. 30, 400 (2023).

携帯電話 広視野撮影

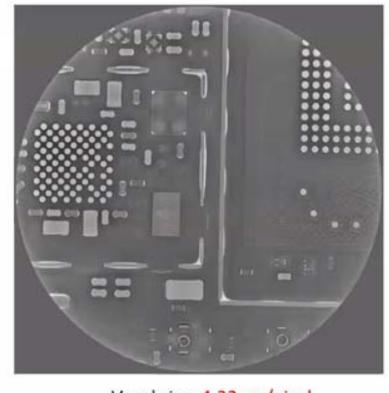






7200projections / 360de₆. 150msec exposure → 25min scan

高分解能撮影



Voxel size: 4.22µm/pixel

7200 projections / 360deg.
200msec exposure → 35min scan

平板状試料の観察を可能にするため、ラミノグラフィー測定システムの整備を行った。

SPRUC 第5回 BLsアップグレード検討ワークショップ SPRUC 5th BLs Upgrade Review Workshop

2023.3.10 Fri 9:00-17:00

11:00 11:30 回折・散乱BL群のアップグレード 理研/JASRI 玉作賢治 Upgrade of diffraction and scattering BLs, RIKEN/JASRI, Kenji Tamasaku

BL40XU 微小単結晶構造解析装置

微小単結晶構造解析

X線回折マッピング gマイクロビーム

➤ BL再編でBL40XUは小角散乱専用に

2024/12 (予定) BL40XU閉鎖 2025/10 (予定) BL05XU (未確定) にて再開

▶ IP検出器は現有の装置が修理不能になる/2024年末まで利用可

BL05XUへ移設の場合に検討しているスケジュール

現在	2024A	2024B	2025A	2025B
40XU 小角			.111	
40XU 単結晶				
05XU R&D				
05XU 小角				
				出红目

于小口目II 7C 1 1 2 24 0+ 口 44 14

新しい単結晶構造解析装置

BL02B1 高エネルギーX線構造解析装置

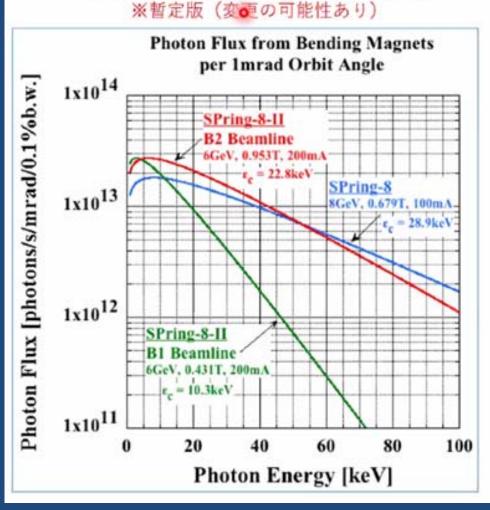
結晶構造解析

- 新規有機材料
- ゼハイスループット

電子密度レベル精密構造解析

- ☆物性系無機材料
- ▼高分解能・高精度

偏向電磁石BLのフラックス比較



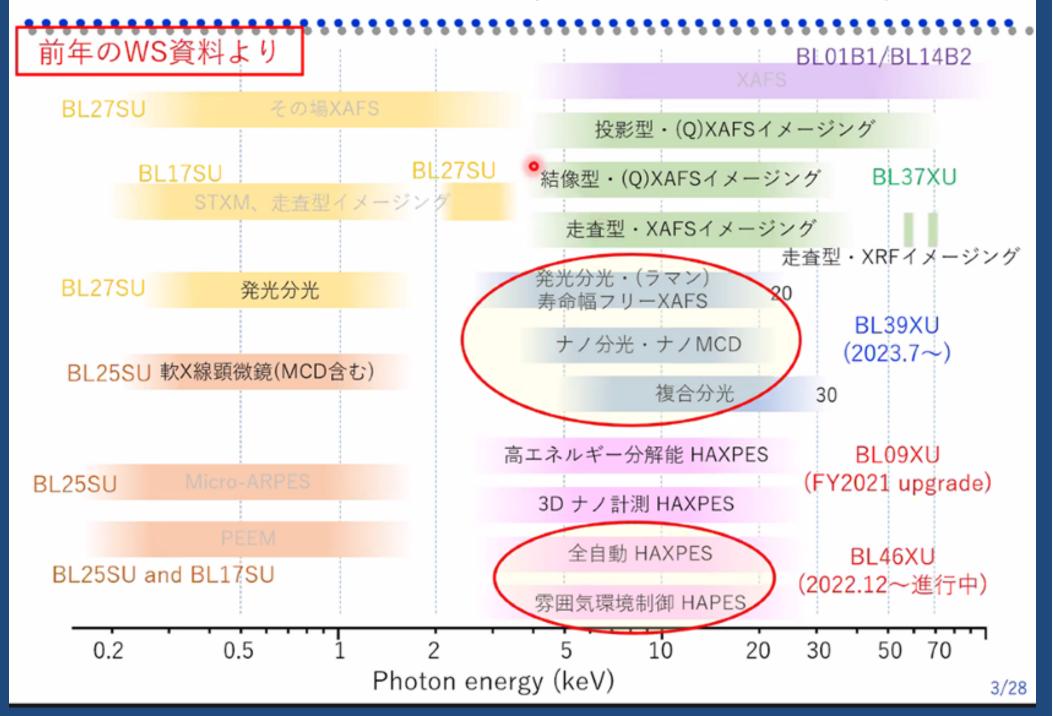
- > 4軸回折計は供用停止中
- ▶ IP検出器は2023A期まで ※動作不安定な制御系の更新のため
- > SPring-8-IIアップグレード
- ・B1ビームラインの10 keV以上で暗くなる
- · B2ビームラインへの移設を検討中
 - ※50 keV以下で少し明るくなる

SPRUC 第5回 BLsアップグレード検討ワークショップ SPRUC 5th BLs Upgrade Review Workshop

2023.3.10 Fri 9:00-17:00

13:00 13:30 分光BL群、BL39XUのアップグレード JASRI 為則雄祐 Upgrade of Spectroscopy BLs and BL39XU, Yusuke Tamenori, JASRI

分光BL群のポートフォリオ(FY2022の検討状況)



SPRUC 第5回 BLsアップグレード検討ワークショップ SPRUC 5th BLs Upgrade Review Workshop

2023.3.10 Fri 9:00-17:00

13:30 14:00 イメージング・SAXS BL群-BL40XUのアップグレード JASRI 登野健介 Upgrade of imaging/SAXS BLs - BL40XU, Kensuke Tono, JASRI

内容

- 1. イントロダクション
 - 対象ビームライン
 - 基本方針
- 2. 共用イメージングBLsのアップグレード進捗・マイクロX線CT自動測定装置@BL28B2の紹介
- 3. SAXS BLsの再編について
- 4. BL40XUの改造計画
- 5. まとめ

対象ビームライン

共用イメージングBL

(赤字部分を今回報告)

BL20B2: 高エネルギーマイクロCT (≦110 keV) 高フラックス (40, 110 keV, DMM) or 単色ビーム (DCM) 大面積ビーム(中尺BL)

BL20XU: マイクロ・ナノCT (≦38 keV、分解能150 nm)

BL28B2: 高エネルギーマイクロCT(自動測定) 白色X線ビーム(~200 keV)

BL47XU: マイクロ・ナノCT (≦15 keV、分解能 <100 nm) 持込み装置 (実験ハッチ2)

共用SAXS BL

BL40B2: 汎用SAXS/WAXS(SWAXS) 自動測定, SEC-SAXS

BL40XU: 時間分解SWAXS、イメージング・SAXS複合計測 高フラックス準単色ビーム

BLアップグレードの基本方針

- 共用BLとして、より効率的な運用を可能とし、既存および潜在ニーズに応 えることで利用の拡大を目指す。
- 測定自動化により、ハイスループットかつタイムリーな測定を実現。
 - ✓ 学術・産業界の多様な研究開発ニーズに応える。
 - ✓ 依頼測定にも対応可能な装置の開発(マイクロCT、SAXS)。
- <u>高エネルギー領域</u>利用に向けた取組みを重点的に実施(イメージングBL)。
- SPring-8全体の高度化・最適化と整合する形でのアップグレードを実施
 - ✓ 光源、光学系、ITインフラの更新
 - ✓ 効率的なBL利用に向けた装置群の再編。

BL28B2: DXAFS装置を撤去(QXAFSへ統合)(済)

BL40XU:SAXS専用BLに改造(FY2025~利用再開)

微小結晶用精密回折計を移設

BL47XU: HAXPES装置をBL09XUへ移設(済)

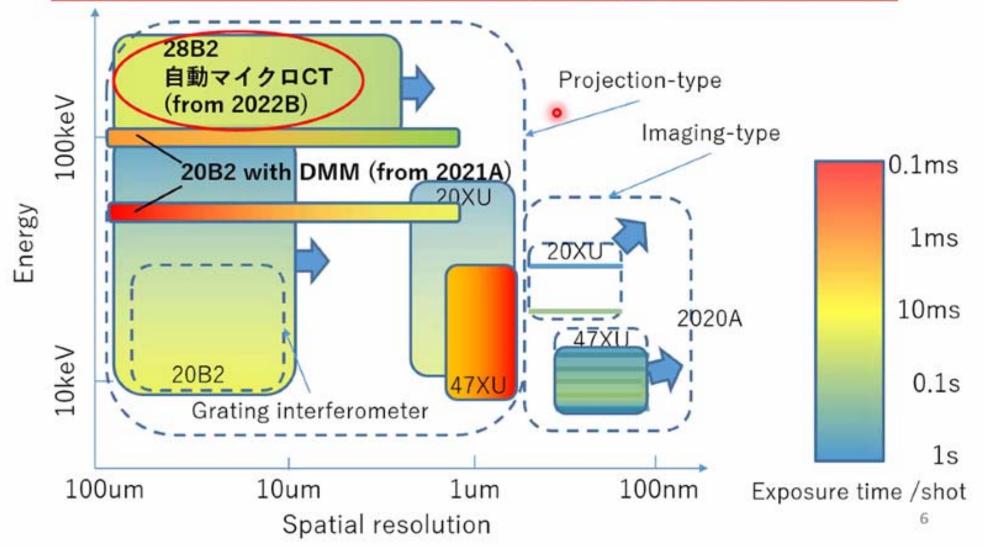
実験ハッチ2を持込み装置用に再整備(済)

内容

- 1. イントロダクション
 - 対象ビームライン
 - 基本方針
- 2. 共用イメージングBLsのアップグレード進捗・マイクロX線CT自動測定装置@BL28B2の紹介
- 3. SAXS BLsの再編について
- **4.** BL40XUの改造計画
- 5. まとめ

共用イメージングBLs (BL20B2, 20XU, 28B2, 47XU)

- マイクロ・ナノイメージング、CT計測のためのBL。
- 4本のBLで幅広いエネルギー領域、分解能・視野範囲、試料環境をカバー。
- 2019年度より、イメージング計測基盤拡充のための高度化を開始。<u>高エネルギーX線の利用拡大と測定自動化による新しい利用者層の開拓を重点的に進めている</u>。



X線マイクロCT自動測定装置(BL28B2)

- 自動測定の「手軽さ」により、潜在的需要を発掘。
- 効率向上、省力化、利用の活性化を実現。
- 高エネルギーマイクロCT実験がより簡便に。
 - ✓ 24時間連続自動測定
 - ✓ 3D画像再構成までのデータ処理も自動化
- 代行測定(1時間単位)が可能: https://user.spring8.or.jp/?p=42152

測定事例1 携帯電話

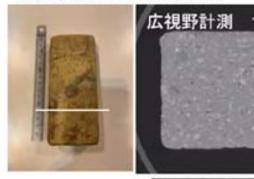




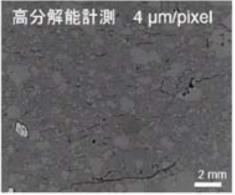
測定事例2 リチウムイオン電池



測定事例3 ブロック状試料



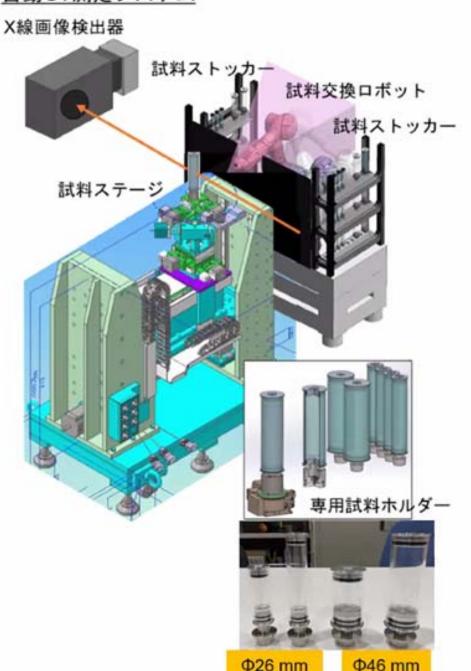






X線マイクロCT自動測定装置 (BL28B2)

<u>自動CT測定システム</u>



現状のスペック

広視野計測

- 投影像視野サイズ: 45mm(H)×1.5mm(V)
- 画素サイズ: 12µm/pixel
- 1CTあたりの測定時間:6min
- 1時間あたり測定可能なボリューム: Φ45mm×10mm*

*試料の鉛直方向への走査が必要

高分解能計測

- 投影像視野サイズ: 16mm(H)×1.5mm(V)
- 画素サイズ:4µm/pixel
- 1CTあたりの測定時間:6min
- 1時間あたり測定可能なボリューム: Φ16mm×10mm*
- 最大試料(専用ホルダー収納可能)サイズ: Φ46mm×150mm, Φ26mm×100mm

予想される利用例・測定事例

- 電池関係(in-situ以外)
- 電子デバイス等接合部(疲労試験との組合わせ)
- 木材・セメント・コンクリート関係
- (鉄鋼材)溶接内部の割れの可視化
- 化石

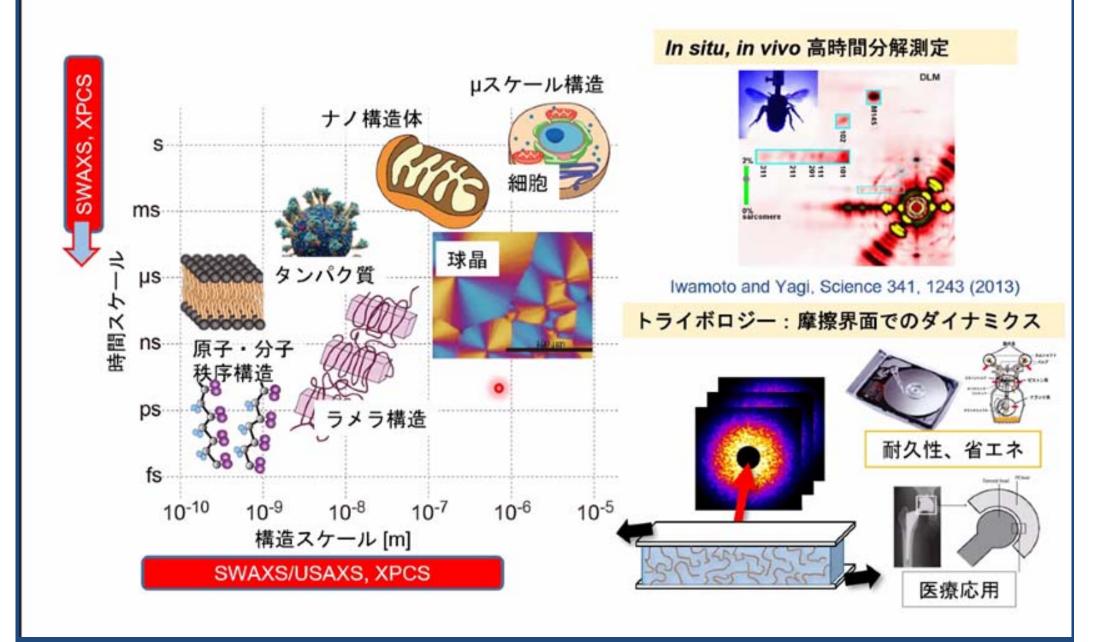
代行測定HP: https://user.spring8.or.jp/?p=42152

内容

- 1. イントロダクション
 - 対象ビームライン
 - 基本方針
- 2. 共用イメージングBLsのアップグレード進捗
 - ・マイクロX線CT自動測定装置@BL28B2の紹介
- 3. SAXS BLsの再編について
- 4. BL40XUの改造計画
- 5. まとめ

BL40XUで目指すもの

幅広い階層性を有する試料の構造・ダイナミクス計測



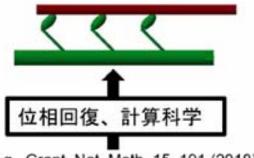
(具体例)SAXSとイメージングの融合

計測システムと解析法の高度化により、実空間情報との組合わせが容易になれば、より幅広いユーザー層の利用が期待できる。

分子構造イメージング

SAXS・イメージング同時計測

SAXS CT



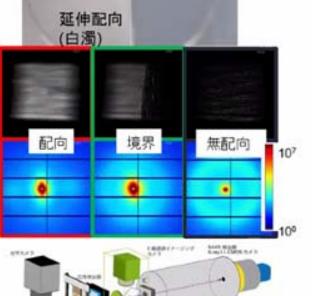
E.g., Grant, Nat. Meth. 15, 191 (2018).

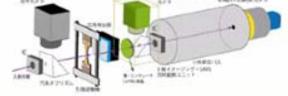


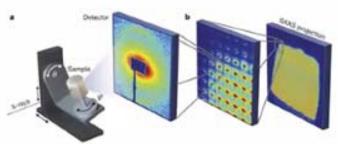
Iwamoto et al., Biophysical Journal 85, 2492 (2003)

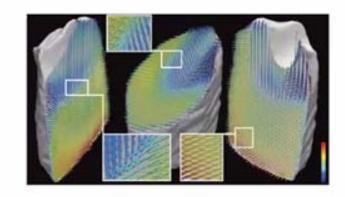


SAXS像









Schaff et al. Nature 527, 353 (2015)

マイクロビームによる高速空間分解計測(X線透過像+SAXSマッピング)は、 複雑系試料の局所解析などの有効なツールとなり得る。

BL40XU SWAXS専用BL化 → BL基幹部も含めた大幅改造

BL40XU: 逆・実空間 動的イメージング

- 高フラックスビームと高速検出器による高速散乱測定/XPCS測定、in-situ測定
- 高フラックスµビームを利用したトライボロジー(摩擦)評価
- 破壊・生成プロセスの逆・実空間可視化

必要とされる性能と改造案

[高速測定]

高フラックスビーム:ID準単色ビーム利用(IDを標準型に入替え)

エネルギー範囲: 8-15 keV + α (高エネルギー領域は他のSAXS BLで)

検出器更新: CITIUS導入

[マイクロビーム]

ウォルターミラー集光光学系: **ミクロン (~1 um) ビーム** 非集光ビーム (~200 x 50 μm) も利用可能

[単色ビーム利用にも対応] **準単色 - 単色ビーム切替え機構** ダブルチャンネルカットモノクロメーター (XPCS、時間コヒーレンス利用、8~15 + α keV)

[カメラ長の延長] カメラ長 ~8 m (USAXS、XPCSに対応)

[コヒーレントX線利用] XPCS、CDI、タイコグラフィー

[大量データ処理] SPring-8 データ・解析インフラ活用